

注目!

# 半導体チップ取付用ケース (高精度シェービング加工)

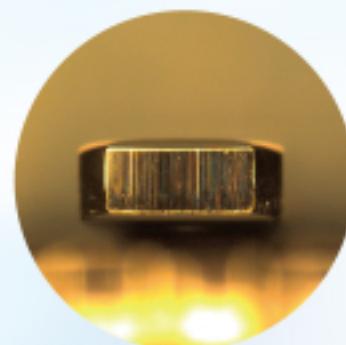
FUJI

高精度の表面粗さ・平面度を有する独自のシェービング加工により、  
半導体取付用ケースの小型化を実現!

## 特徴

従来は【図①】の様に金属性端子をL字状に屈曲させてワイヤーボンディング面を作成しておりましたが、屈曲させる事なく、直線状に形成された先端の煎断面に高精度なシェービング面を形成する事により、従来比30%の小型化、10%の低価格化を実現しました。

表面粗さ：RZ=1μm以下  
平面度：1μm以下



## アプリケーション

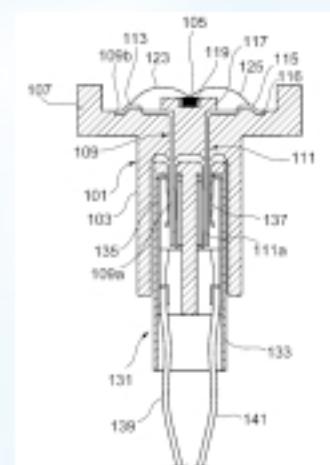
ワイヤーボンディングを必要とする温度・圧力センサー用ケース



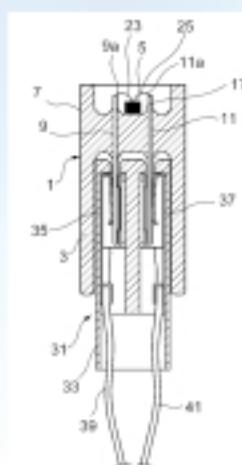
【図①】従来タイプ



【図②】小型化ケース



従来比  
30%  
小型化!



(11)特許番号  
特許第3954074号  
(P3954074)